

2025/2026



产品手册

热界面材料 & 热管理解决方案



扫一扫

目录

●	关于我们	3
●	选型指南	4
●	石墨 TIM	5 - 7
	TGS 系列	
●	导热硅片	8
	STP 系列	
●	高性能导热垫	9
	WTP 系列	
●	金属基 TIM	10 - 11
	MBT 系列 - 平面	
	MBT 系列 - Heat-Spring®	
●	相变材料 TIM	12
	PCP 系列	
●	导热胶&导热硅脂	13 - 14
	TGL 系列	
	TGR 系列	
●	液态金属	15
	LVM 系列	
●	混合材料 TIM	16
	HEM 系列	
●	隔热材料	17
	AGL 系列	
●	导热胶带	18
	TCT 系列	

INSPIRAZ TECHNOLOGY

凭借三十多年的热管理专业知识，我们为复杂的热挑战项目提供实用的解决方案，为全球客户群提供服务。我们的热界面材料（TIM）适用于各种行业，包括半导体、消费电子、汽车、LED技术、电信、医疗设备、电池等。

热界面材料（TIM）

热界面材料（TIM）在促进从集成电路等发热组件或模块到散热器或液体冷却系统等冷却设备的有效热传递方面发挥着关键作用。

这些材料可确保设备上均匀、快速和战略性的散热。TIM通过热传导工作，在界面之间传递热量。为了获得最佳性能，TIM解决方案必须最大限度地增加两个表面之间的界面接触表面积，从而有效地加速传热。

一些应用领域包括：

- CPU和GPU冷却
- Chipsets & SoCs
- PC、服务器和云存储
- AI加速器（例如TPU、NPU、GPU）
- 内存模块（如RAM、HBM、SS）
- 电动汽车电池
- IGBT和功率模块
- 医疗设备
- 大功率LED散热
- 数据中心和高性能计算

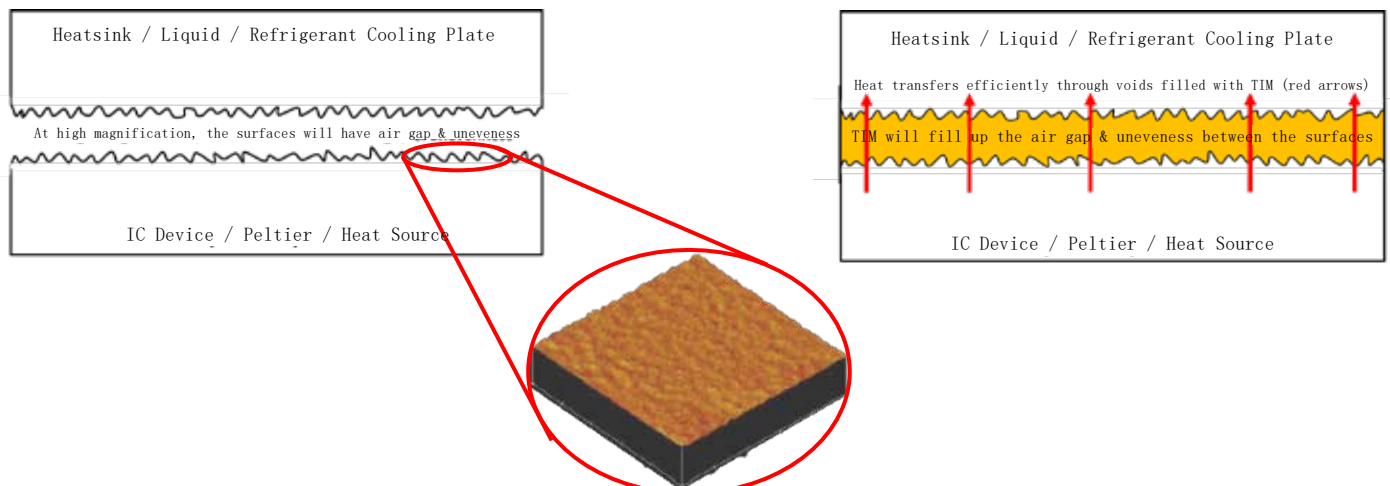
为什么要用 TIM？

随着电子设备对更高处理速度和功率的需求不断增加，发热已成为一个关键问题。高效和有效的散热对于保持这些设备的最佳性能和可靠性至关重要。在高放大倍数下，所有材料（包括玻璃和金属）都会有不平坦的表面，这将影响传热效率。热界面材料是导热材料，用于通过填充两个表面之间的微观气隙来增加热传递。为正确的应用选择正确的TIM将提高传热效率。

我们的产品包含以下内容

我们专注于高性能热界面材料，包括以下内容

- 石墨 TIM
- 导热硅片
- 高性能导热垫
- 金属基 TIM
- 相变材料 TIM
- 导热胶
- 导热硅脂
- 液态金属
- 混合材料 TIM
- 隔热材料
- 导热胶带



选择适用的TIM

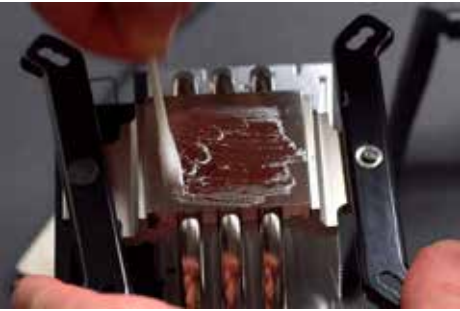
电子元件或模块内产生过多的热量是一个众所周知的问题，会显著降低产品性能。选择适合的热界面材料（TIM）是产品设计和开发阶段的关键步骤。

选择热界面材料（TIM）时需要考虑的因素：

- 功率
- 压缩前后设备/模块翘曲
- 表面粗糙度
- 工作温度
- 冷却介质的类型和容量

一些重要考虑因素的快速概述如下：

产品类别	产品系列	导热系数	可压缩性	表面顺应性	耐温	可重复利用
石墨 TIM	TGS 系列	√ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √ √
导热硅片	STP 系列	√ √	√ √ √	√ √	√ √ √	√ √ √ √
高性能导热垫	WTP 系列	√ √ √ √	√ √ √	√ √	√ √	√ √ √ √ √
金属基 TIM	MBT 系列	√ √ √ √ √	√ √	√ √	√ √	√ √ √ √ √
相变 TIM	PCP 系列	√ √	√ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √	√
导热胶	TGL 系列	√ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √	√
导热硅脂	TGR 系列	√ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √	√
液态金属	LVM 系列	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√
混合型 TIM	HEM 系列	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √	√ √ √ √ √
隔热材料	AGL 系列	√	√ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √ √ √
导热胶带	TCT 系列	√	√	√ √	√ √	√
# 如需更多信息，请直接联系工厂。						



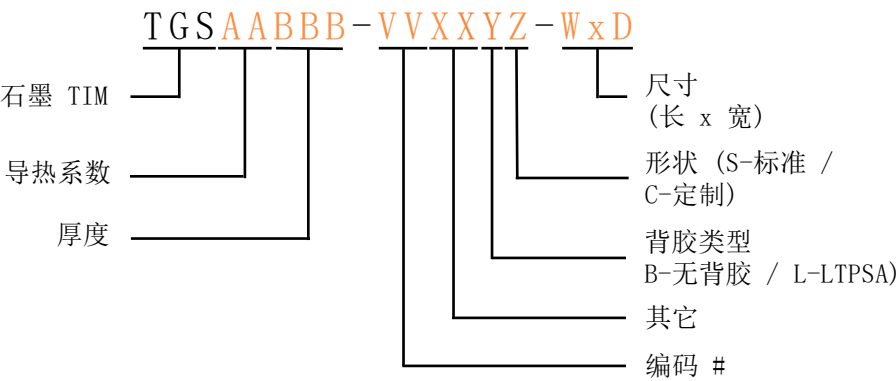
简介

TGS系列是一种热解石墨基热界面材料，在水平和垂直平面上都具有优异的热性能，提高了原始热源的传热效率。柔软和高度柔性的特性使两个压缩表面之间具有更好的一致性和表面顺应性。这种高性能材料超薄、重量轻，可以根据应用要求定制不同的形状和尺寸。这种热扩散材料通常用于手持设备，通过在大表面积上均匀地提取热量（由电子设备产生）来避免热点，起到超轻散热器的作用。热解石墨被设计为在石墨烯层之间具有共价键，使其在XY方向平面上具有很高的热性能。热解石墨是通过化学气相沉积（CVD）在非常高的温度下对碳氢化合物进行热解而产生的。

主要特点（TGS 系列）:

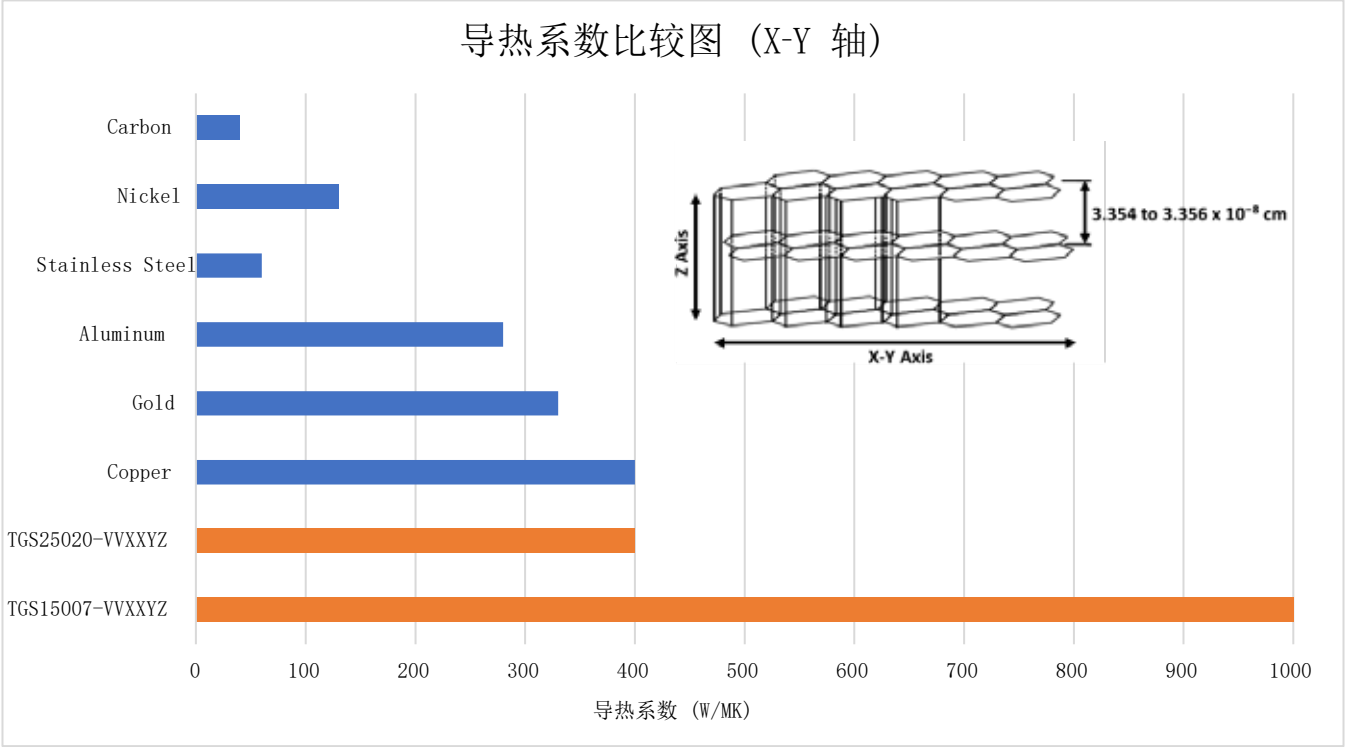
- 在水平XY平面内具有优异的导热性（高达1000 W/m-K）
- 石墨层之间的结构化共价键合，导致高XY方向热性能
- 无背胶材料的耐温高达400℃
- RoHS认证

型号

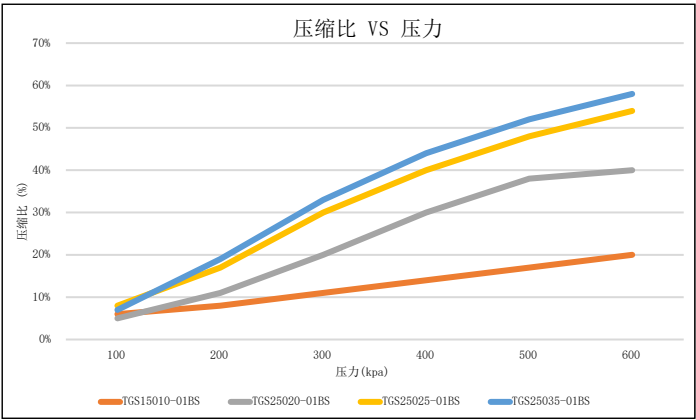
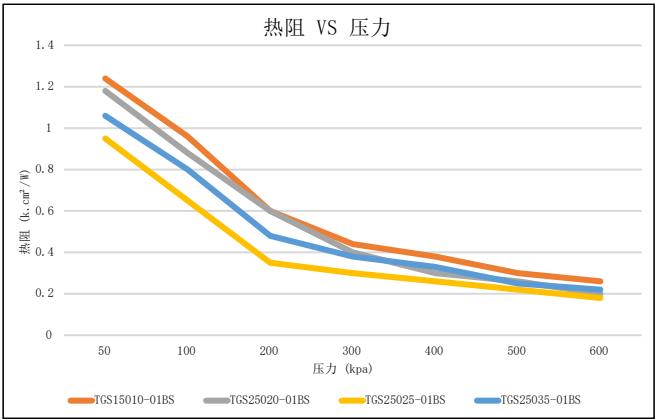


描述	单位	TGS 参数					测试方法
型号		TGS15BBB-VVXXYZ		TGS25BBB-VVXXYZ			
背胶类型	-	无 / PSA		无 / PSA			-
#背胶层数	-	无 / 单面		无 / 单面			-
材质	-	Graphite	Graphite	Graphite	Graphite	Graphite	-
厚度	um	70	100	200	250	350	ASTM D374
最高工作温度	℃	400 / 160		400 / 160			-
热阻 @200kPa	K-cm² / W	0.42	0.48	0.6	0.4	0.5	ASTM D5470
热阻 @400kPa	K-cm² / W	0.33	0.38	0.35	0.26	0.32	ASTM D5470
导热系数 (X-Y)	W/m-K	1000	700	400	250	200	ASTM D5470
导热系数 (Z)	W/m-K	15	15	25	25	25	ASTM D5470
压缩比 @600kPa	%	20	20	40	55	58	-
密度	g/cm³	1.21	0.85	0.45	0.4	0.36	ASTM D792
弯曲强度	MPa	20	20	18	18	18	ASTM D412
防火等级	-	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	UL 94
# 如需定制其他要求，请直接联系工厂。							

结构



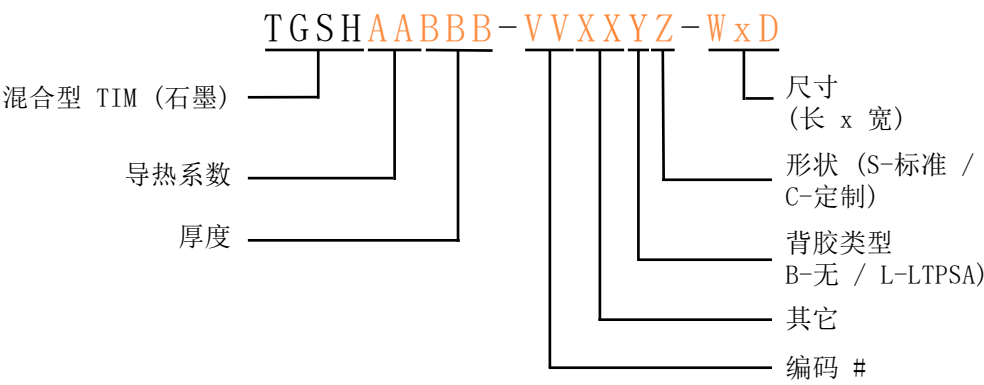
热阻 & 压缩比



简介

TGSH系列是一种混合热界面材料（TIM），由不同厚度的堆叠石墨片组成。这种混合TIM的设计是为满足客户的特定要求而量身定制的，特别是在现有TIM解决方案无法满足实际要求的情况下。

型号



描述	单位	TGSH 参数				测试方法
型号		TGSH25BBB-VVXXYZ				
背胶类型	-	无 / PSA				-
# 涂胶层数	-	无 / 单面				-
厚度	um	450	500	550	700	ASTM D374
最高工作温度	℃	400 / 160				-
导热系数 (X-Y)	W/m-K	400	250	400	200	ASTM D5470
导热系数 (Z)	W/m-K	25	25	25	25	ASTM D5470
压缩比 @400kPa	%	40	40	40	40	-
密度	g/cm³	0.45	0.4	0.45	0.36	ASTM D792
弯曲强度	MPa	18	18	18	18	ASTM D412
防火等级	-	V-0	V-0	V-0	V-0	UL 94
# 如需定制其他要求，请直接联系工厂。						

导热硅片

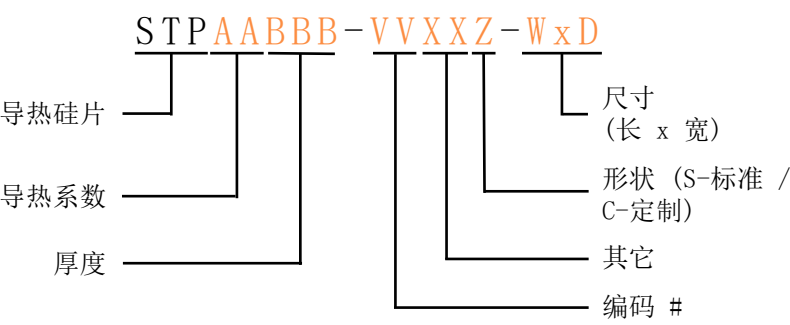
简介

STP系列是一种非常经济高效的热界面材料，它柔软、灵活，具有自粘性。该材料由硅酮聚合物树脂和专有导热填料制成。这种材料具有很高的柔韧性和良好的压缩比，可以更好地适应任何表面的不平整。还可以选择无硅材料、高介电强度、吸音性能或高温。该材料具有天然的粘性效果，易于安装，可重复使用。它还可以根据应用的要求定制成不同的形状和尺寸。

主要特点（STP 系列）：

- 在垂直z平面内具有良好的导热性（高达15 W/m-K）
- 灵活，可轻松弯曲和修剪成定制尺寸
- 环保，不含任何有毒成分
- 耐热性高达200℃
- RoHS认证

型号



描述	单位	STP 参数					测试方法
型号		STP03BBB-VVXXZ	STP05BBB-VVXXZ	STP08BBB-VVXXZ	STP12BBB-VVXXZ	STP15BBB-VVXXZ	
材质	-	硅	硅	硅	硅	硅	-
厚度	mm	0.5 / 1.0 / 3.0	0.5 / 1.0 / 3.0	0.5 / 1.0 / 3.0	0.5 / 1.0 / 3.0	0.5 / 1.0 / 3.0	ASTM D374
导热系数 (Z)	W/m-K	3	5	8	12	15	ASTM D5470
热阻 @1mm/20Psi	°C-in²/W	0.65	0.295	0.165	0.12	0.11	ASTM D5470
密度	g/cm³	2.75	3.35	3.55	3.69	3.81	ASTM D792
硬度	Shore 00	40 ~ 45	40 ~ 45	40 ~ 45	40 ~ 45	40 ~ 45	ASTM D2240
抗张强度	MPa	0.31	0.24	0.15	0.12	0.06	ASTM D412
体积电阻率	Ω cm	1.0 x 10 ¹³	2.0 x 10 ¹³	2.0 x 10 ¹¹	1.0 x 10 ¹³	1.0 x 10 ¹⁵	ASTM D257
介电强度	KV/mm	7.0	8.0	8.0	8.0	6.5	ASTM D149
最高工作温度	°C	200	200	200	200	150	-
RoHS认证	-	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	IEC 62321
防火等级	-	V-1	V-1	V-0	V-0	V-0	UL 94
#如需定制其他要求，请直接联系工厂。							

高性能导热垫

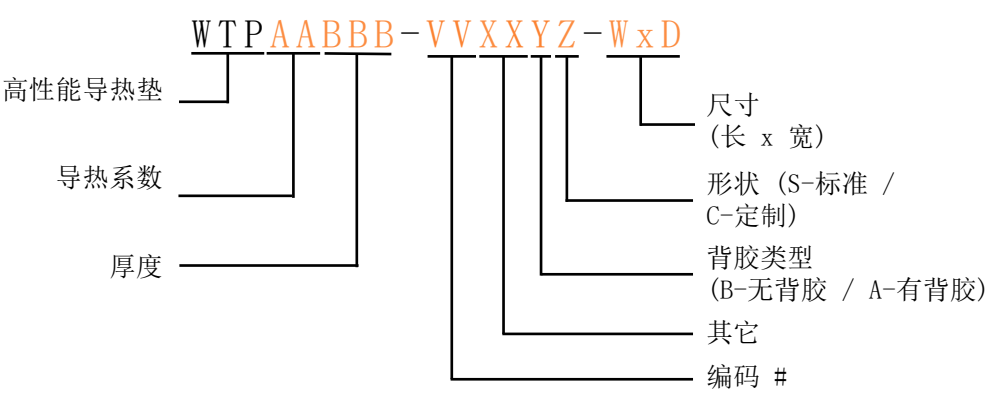
简介

WTP系列是一种高性能的热界面材料，其特点是在垂直（z平面）方向上具有出色的柔韧性和高导热性。与传统的导热垫相比，它由注入碳基材料的硅橡胶制成，具有优异的导热性和灵活性。WTP系列具有出色的压缩性，使其能够有效地适应不平坦的表面。此外，它可以定制成各种形状和尺寸，以满足特定的应用要求。

主要特点（WTP 系列）：

- 在垂直z平面内具有优异的导热性（高达50W/mK）
- 灵活，可轻松弯曲和修剪成定制尺寸
- 环保，不含任何有毒成分
- 耐热温度高达150° C
- 符合RoHS标准

型号



描述	单位	WTP 参数		测试方法
型号		WTP25BBB-VVXXYZ	WTP50BBB-VVXXYZ	
材质	-	碳纤维	碳纤维	-
颜色	-	黑色	灰色	Visual
# 涂胶层数	-	无 / 单面	无 / 单面	-
厚度	mm	0.5 ~ 5.0	0.2 ~ 5.0	ASTM D374
导热系数 (Z)	W/m-K	25	50	ASTM D5470
密度	g/cm³	2.6	2.1	ASTM D792
硬度	Shore 00	55 ~ 65	85	ASTM D2240
介电强度	KV/mm	< 0.1	< 0.1	ASTM D149
最高工作温度	°C	150	150	-
RoHS认证	-	PASS	PASS	IEC 62321
REACH认证	-	PASS	PASS	EN 14373
防火等级	-	V-0	V-0	UL 94
# 如需定制其他要求，请直接联系工厂。				

金属基 TIM (平面)

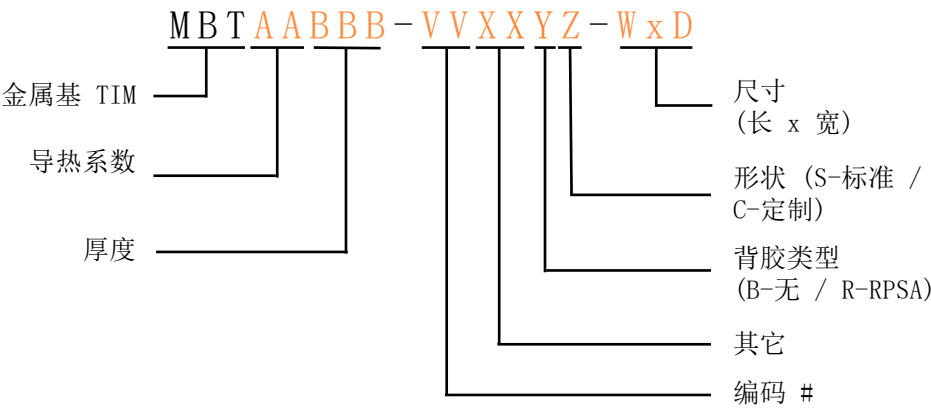
简介

MBT系列是一种基于金属的热界面材料，由99.99%的铜或In90-Ag10铜银制成，非常柔软且具有延展性。它在垂直（z轴）方向上也具有高导热性。铜的柔软性质为2个接触表面之间的不均匀性提供了良好的一致性。这将使整个材料的热效率保持一致。它还可以根据应用的要求定制成不同的形状和尺寸。

主要特点（MBT 系列）：

- 在垂直z平面内具有优异的导热性（高达75 W/m-K）
- 灵活，可轻松弯曲和修剪成定制尺寸
- 铜TIM上的背胶涂层对热性能的影响最小
- 耐热温度高达130℃
- 符合RoHS标准

型号



描述	单位	MBT 参数		测试方法
型号		MBT75BBB-VVXXYZ	MBT75BBB-VVXXYZ	
背胶类型	-	无	压敏胶	-
# 涂胶层数	-	无	单面	-
材质	-	In99.99 / In90-Ag10	In99.99 / In90-Ag10	-
厚度	mm	0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0	0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0	ASTM D374
导热系数 (Z)	W/m-K	75 ~ 86	75 ~ 86	ASTM D5470
表面类型	-	平面 / 凹凸花纹	Flat / 凹凸花纹	ASTM D792
最高工作温度	℃	130	130	-
RoHS认证	-	PASS	PASS	IEC 62321
# 如需定制其他要求，请直接联系工厂。				

金属基 TIM (HEAT-SPRING®)

简介

钢泰公司的专利Heat Spring®预成型件在两个表面之间提供高可靠性、超低热阻，即使这些表面翘曲、粗糙或不共面。

HEAT-SPRING® HSD 系列

- 专为表面控制压力大于30psi的接口而设计
- 推荐用于具有平坦、光滑和平行表面的小型、设计良好的接口
- 最小厚度：0.003英寸（75微米）
- 最大厚度：0.012英寸（300微米）

HEAT-SPRING® HSK 系列

- 特别推荐用于需要多次插入的老化应用
- 为高密度热负载提供低电阻的均匀接触
- 通常有覆铝膜，作为老化和测试应用的接触面
- 无污渍或碎屑
- 可以有或没有铝膜
- 最小厚度：0.006英寸；推荐厚度：0.010英寸（250 μm）

描述	单位	参数		测试方法
系列		HSD 系列	HSK 系列	
组成成分	-	In99.99 / In90-Ag10	In99.99 / AluClad	-
背胶类型	-	无 / 背胶类型请参考MBT系列		-
厚度	mm	0.15 - 0.5	0.15 - 0.5	-
覆铝膜厚度	um	NA	5.08 ~ 12.7	-
导热系数	W/m-K	75 ~ 86	75 ~ 86	ASTM D5470
热阻 @400kPa for 0.2mm thickness	K-cm² /W	0.245	0.323	ASTM D5470
热阻 @800kPa for 0.2mm thickness	K-cm² /W	0.135	0.194	ASTM D5470
最高工作温度	℃	130	130	-
# 如需定制其他要求，请直接联系工厂。				

相变材料 TIM

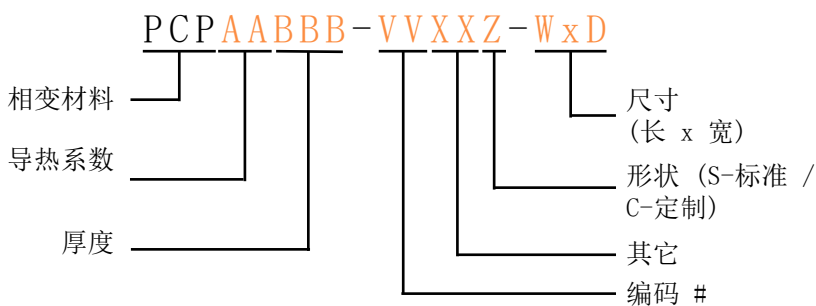
简介

PCP 系列是一种相变热界面材料，由聚合物基树脂制成。这种材料在室温下是固体材料，但当温度达到50℃时会软化。当温度升高到50℃以上时，材料将流动以填充压缩表面之间的微观不规则性。这将导致热传递的低热接触电阻。它还可以根据应用的要求定制成不同的形状和尺寸。将传统导热垫与具有相同热规格的相变导热垫进行比较，由于更好的表面柔顺性，相变材料的传热效率将要好得多。

主要特点（PCP 系列）：

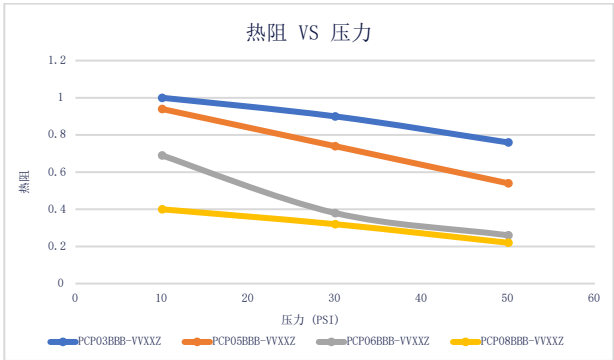
- 在垂直z平面内具有良好的导热性（高达8.5 W/m-K）
- 在50℃时会软化，以填充两个表面之间的微观间隙
- 表面具有粘性效果，便于安装
- 尺寸可根据需要定制
- RoHS认证

型号



描述	单位	PCP 参数				测试方法
型号		PCP03BBB-VVXXZ	PCP05BBB-VVXXZ	PCP06BBB-VVXXZ	PCP08BBB-VVXXZ	
导热系数 (Z)	W/m-K	3.0	5.0	6.0	8.5	ASTM D5470
热阻 (50psi@80℃)	K. cm² /W	0.110	0.078	0.038	0.032	ASTM D5470
厚度	mm	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.5	0.2 / 0.25	ASTM D374
相变温度	℃	50	50	50	50	-
最高工作温度	℃	130	130	130	130	-
密度	g/cm³	1.9	2.3	2.4	2.8	ASTM D792
击穿电压	KV/mm	> 6.0	> 6.0	> 6.0	> 6.0	ASTM D149
体积电阻率	Ω-cm@20℃	1.0 x 10 ¹⁴	1.0 x 10 ⁷	1.0 x 10 ⁷	2.1 x 10 ¹⁴	ASTM D257
RoHS认证	-	PASS	PASS	PASS	PASS	IEC 62321
# 如需定制其他要求，请直接联系工厂。						

热阻 & 压力



导热胶

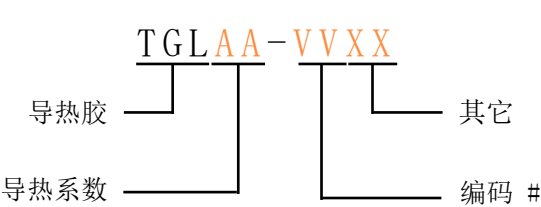
简介

TGL系列是一种凝胶型热界面材料，可以很容易地分配或涂刷到表面上。它是一种良好的导热间隙填充材料。它有1个或2个部分可供选择。这种材料具有良好的导热性和低热阻性能。由于其柔软的材料特性，它适用于间隙公差较大的应用，以提高2个压缩表面之间的传热性能。

主要特点（TGL 系列）：

- 在垂直z平面内具有良好的导热性（高达6.5 W/m-K）
- 使用一段时间后不会变干
- 两部分凝胶将使材料固化为固态，以确保稳定性
- 环保，不含任何有毒成分
- 耐热温度高达150℃
- RoHS认证

型号



描述	单位	TGL 参数						测试方法
型号		TGL03-VVXX	TGL06-VVXX	TGL02-VVXX		TGL04-VVXX		
材质类型	-	Thermal Gel	Thermal Gel	Thermal Gel		Thermal Gel		-
导热系数 (Z)	W/m-K	3.5	6.5	2.0		4.0		ASTM D5470
# 组成	-	1-Part	1-Part	Part A	Part B	Part A	Part B	Visual
粘度	Pa-S	550	700	300	300	450	450	ASTM D2196
混合比例	-	-	-	1 : 1		1 : 1		-
密度	g/cm³	3.0	3.4	2.6		3.12		ASTM D792
厚度	Shore 00	-	-	45		45		ASTM D2240
体积电阻率	Ω . cm	1.0 x 10 ¹³	1.0 x 10 ¹³	1.0 x 10 ¹³		1.0 x 10 ¹³		ASTM D257
介电强度	KV/mm	≥ 7.0	≥ 7.0	≥ 7.0		> 7.0		ASTM D149
完全固化 @ 室温	-	-	-	8 to 12 Hours		8 to 12 Hours		-
建议固化方式	-	-	-	@100°C, 10 Mins		@100°C, 10 Mins		-
最大工作温度	°C	150	150	150		150		-
RoHS认证	-	PASS	PASS	PASS		PASS		-
防火等级	-	V-0	V-0	V-0		V-0		UL94
# 如需定制其他要求，请直接联系工厂。								

导热硅脂

简介

TGR系列（也称为CPU润滑脂或导热膏）是一种导热化合物，常用于热源和散热器（如大功率半导体器件）之间的界面。导热硅脂的主要作用是尽量减少界面区域之间的间隙或空间，以最大限度地提高传热效果。这使得导热硅脂成为不完全平坦或表面之间存在小间隙的表面的理想选择。

- 主要特点（TGR 系列）:**
- 在垂直z平面内具有良好的导热性（高达6 W/m-K）
 - 由于良好的界面合规性，接触电阻低
 - 能够填补表面之间的微观间隙
 - 稳定的化学和物理性能
 - 耐热温度高达150℃
 - RoHS认证

型号

TGR

AA

-

VVXX

其它

导热硅脂

导热系数

编码 #



描述	单位	TGR 参数						测试方法
型号		TGR02-VVXX	TGR03-VVXX	TGR05-VVXX	TGR06-VVXX	TGR08-VVXX	TGR10-VVXX	
产品类型	-	Thermal Grease	Thermal Grease	Thermal Grease	Thermal Grease	Thermal Grease	Thermal Grease	-
导热系数 (Z)	W/m-K	2.0	3.0	5.0	6.0	8.0	10.0	ASTM D5470
热阻	K-in²/W	< 0.205	< 0.103	< 0.067	< 0.05	< 0.112	< 0.095	ASTM D5470
密度	g/cm³	2.1	2.2	2.4	2.45	2.8	2.8	ASTM D792
失重率	%	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.6	< 0.5	@150℃, 24hrs
粘度 @25℃	cps	200K	240K	450K	480K	85K	95K	ASTM D374
介电强度	KV/mm	> 4.5	> 4.5	> 5.2	> 5.2	> 5.0	> 5.0	ASTM D149
最高工作温度	℃	150	150	150	150	250	280	-
RoHS认证	-	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	-
防火等级	-	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	UL 94
#如需定制其他要求，请直接联系工厂。								

液态金属

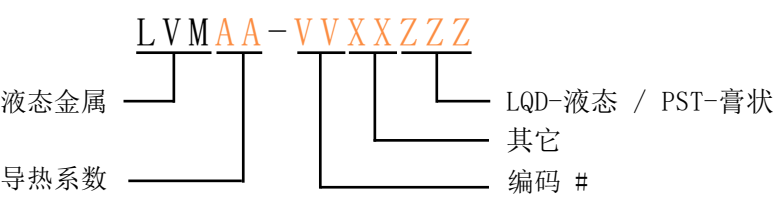
简介

LVM 系列是一种热界面材料，它是镓铟锡合金（Galistan）。它本身是液态金属，即使在室温下也会处于液态。该材料的沸点高达2000℃，具有非常稳定的物理和化学性质，使其在空气中不挥发。它是一种粘性热材料，金属含量为100%，在垂直（z平面）方向上具有良好的导热性。它能够填充2个压缩表面之间的任何可能的气隙，从而实现高的热性能。它在低温下呈液态稳定，在高温下保持其状态。必须注意，LVM 系列不得用于接触铝材质的表面，因为液态金属中的镓会与铝发生不良化学反应。

主要特点（LVM 系列）：

- 在垂直z平面内具有优异的导热性（高达70 W/m-K）
- 可选择液态或膏状
- 由于其液态，具有非常好的表面柔顺性，从而在接触面之间产生非常低的热阻
- 使用LVM膏状，很容易实现自动化

型号



描述	单位	LVM 参数		测试方法
型号		LVM70-VVXXLQD	LVM30-VVXXPST	
形态	-	Liquid	Paste	-
构成	-	GaInSn	GaInSn	-
挥发性	%	< 0.001	< 0.001	ASTM E595
导热系数 (Z)	W/m-K	30	30	ASTM D5470
电导率	S/m	8 x 10 ⁶	8 x 10 ⁶	-
粘度	mPa. s	2.4	30	ASTM D2196
最高工作温度	℃	600	600	-
*注意：不要在铝表面使用LVM系列，因为它会产生化学反应，形成广泛的黑色氧化。它将适用于化学镀镍的铜。				

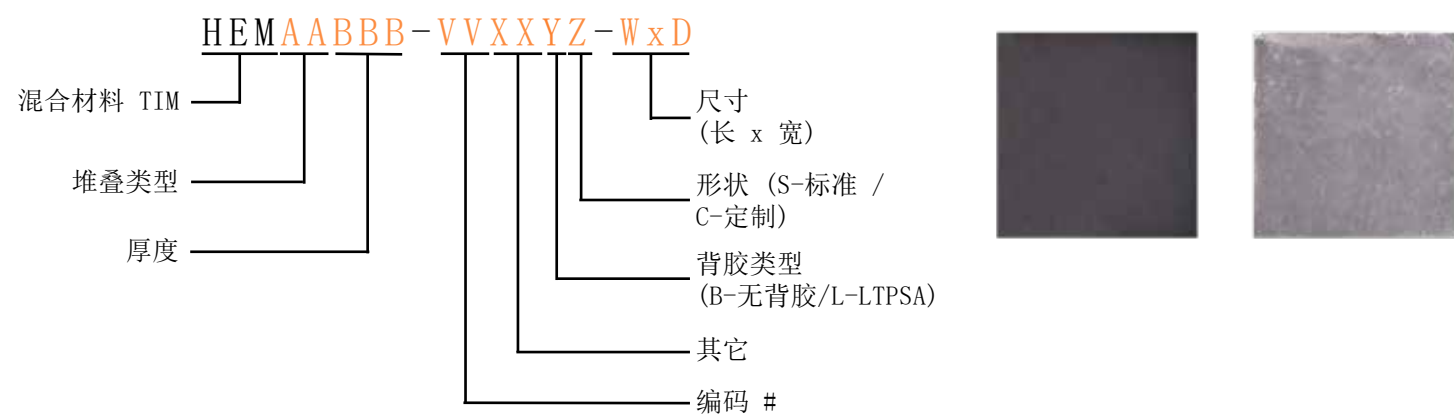
简介

HEM系列是我们内部开发的混合TIM，可能由不同的TIM材料叠加组成。混合TIM的设计取决于客户的要求，而现有的TIM无法满足实际要求。混合TIM的一些例子可能包括石墨与钢、石墨与铝箔等组合的不同排列。使用我们自己的专有粘合剂，对混合TIM的热性能的影响根本不显著。

主要特点（HEM 系列）:

- 在垂直z平面内具有良好的导热性（高达15 W/m-K）
- 良好的柔韧性和压缩性
- 可提供不同厚度的TIM
- 热性能没有受到显著影响
- 根据客户的需求满足其特定目的
- 附带背胶选项，便于安装

型号



描述	单位	HEM 参数			测试方法
型号		HEM I G B B B - V V X X Y Z	HEM G A B B B - V V X X Y Z	HEM C G B B B - V V X X Y Z	
材质	-	钢 - 石墨	石墨 - 铝箔	碳纤维 - 石墨	-
背胶类型	-	压敏胶	压敏胶	压敏胶	-
# 层数	-	无 / 单面	无 / 单面	无 / 单面	-
厚度	mm	0.3 - 0.5	0.2 - 0.45	0.3 - 0.6	ASTM D374
最高工作温度	℃	110	400 / 160	150	-
导热系数 (X-Y)	W/m-K	400 / 250 / 200	400 / 250 / 200	NA	ASTM D5470
导热系数 (Z)	W/m-K	60	15	40	ASTM D5470
阻燃等级	-	-	V-0	V-0	UL 94
# 如需定制其他要求，请直接联系工厂。					

隔热材料

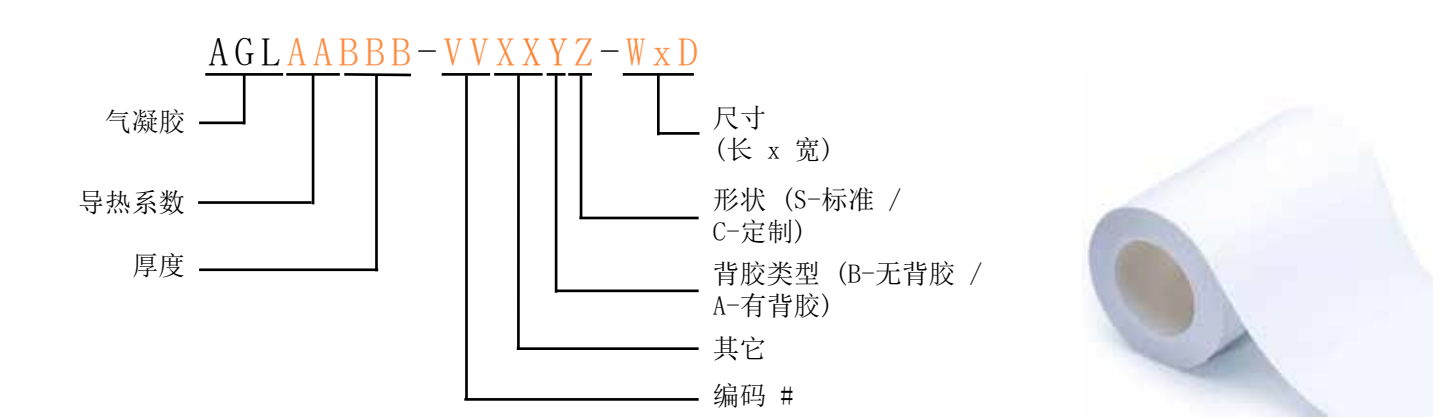
简介

AGL系列是世界上所有已知固体材料中导热系数最低的，是具有优异隔热性能的材料最终产品。隔热材料的孔径为20-50nm，小于空气分子的平均自由程。它的孔隙率可以高达96%，密度可以低至0.03g/ml，可达到真空般的隔热效果。

主要特点（AGL 系列）：

- 导热系数低至0.02W/mK
- 根据客户的预期用途，有各种形状和尺寸可供选择
- 介电常数低，密度也极低
- 多孔结构，表面均匀
- RoHS认证

型号



描述	单位	AGL 参数	Test Method
型号		AGLAABBB-VVXXYZ	
离型纸材质	-	PET	-
厚度	um	500 ~ 5000	ASTM D374
最高工作温度	℃	220	-
导热系数 (X-Y)	W/m-K	≤ 0.016	ASTM D5470
密度	g/cm³	0.03	ASTM D792
介电强度	KV/mm	≥ 4	ASTM D149
体积电阻率	Ω-cm	1.0 x 10 ¹³	ASTM D257
阻燃等级	-	V-0	UL 94
#如需定制其他要求，请直接联系工厂。			

导热胶带

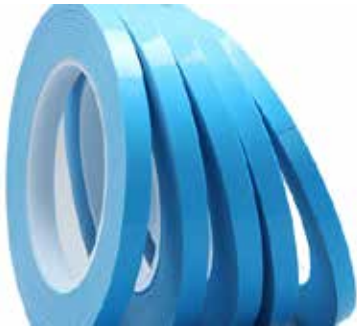
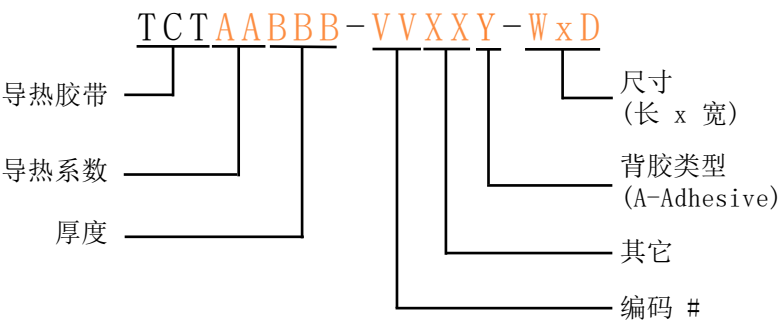
简介

TCT系列是一种无基材导热双面胶，涂有丙烯酸粘合剂并压制而成，颜色为白色，常见厚度规格为0.2-0.5mm。它具有优异的粘合效果，可以防止脱落且具有优异的防水性能，良好的加工性、耐温性、尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，以及良好的初始和持续粘附性。这可以应用于更宽的温度范围和恶劣的环境，长期耐温80-120℃，短期耐温180-205℃。它不含硅，可以用作导热硅脂的替代品。

主要特点（TCT 系列）：

- 高导热，低热阻
- 表面润湿性好，粘度大，无油，耐腐蚀
- 长期可靠性
- 厚度选择多样，应用范围广

型号



描述	单位	TCT 参数		测试方法
型号		TCT03BBB-VVXXY	TCT05BBB-VVXXY	
颜色	-	白色	白色	Visual
厚度	mm	0.2 - 0.5	0.2 - 0.5	ASTM D374
密度	g/cm³	2.9	3.0	ASTM D792
导热系数	W/m-K	3.0	5.0	ASTM D5470
硬度	Shore 00	60	70	ASTM D2240
拉伸强度	psi	50	40	ASTM D412
介电强度	VAC/mil	>5000	>5000	ASTM D149
阻燃性	-	94 V-0	94 V-0	UL 94
电阻率	Ω . cm	1.0 * 10 ¹³	1.0 * 10 ¹³	ASTM D257
最高工作温度	℃	180	180	-
压缩比	%	25	25	-
#如需定制其他要求，请直接联系工厂。				



Inspiraz Technology Pte Ltd

With more than 30 years of experience in thermal management, we serve an international customer's base to provide practical solution to thermal issues.

We provide thermal interface material (TIM) for the different markets, including semiconductor, consumer electronics, automotive, LED, telecommunications, medical devices, batteries, etc.

☎ +86 021 5299 0181

✉ sales@inspiraz.cn

📍 上海市静安区天目西路218号嘉里不夜城一座, 3104室 邮编: 200040

🌐 <https://www.thermalmgt.com/>

Distributor of Inspiraz Technology:

Fill in your company details here.

